

### 雷射切割操作人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	MPM7223-005v3	雷射切割操作人員	最新版本	略	2024/12/15
V2	MPM7223-005v2	雷射切割技術人員	歷史版本	已被《MPM7223-005v3》取代	2021/12/31
V1	MPM7223-005v1	雷射切割技術人員	歷史版本	已被《MPM7223-005v2》取代	2019/12/19

職能基準代碼		MPM7223-005v3			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	雷射切割操作人員		
所屬 類別	職類別	製造 / 生產管理		職類別代碼	MPM
	職業別	金屬工具機設定及操作人員		職業別代碼	7223
	行業別	製造業 / 金屬製品製造業		行業別代碼	C2511
工作描述		從事金屬雷射切割相關技術工作及切割機保修等工作			
基準級別		3			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1工作 圖判讀	T1.1圖樣 及材料表 檢查		P1.1.1 依照工作圖面及材料需求，選用及確認合適的雷射切割組件規格。	3	K01材料規格 K02識圖與製圖 K03公差配合 K04表面織構符號	S01工作圖判讀能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
	T1.2加工資訊蒐集		P1.2.1 統整加工資訊的蒐集與分類，並運用於加工作業。 P1.2.2 學習運用新技術於工作領域。	3	K05機具切割能力判讀原則 K06科技發展概論	S02加工資訊蒐集能力
T2切割模擬測試與雷射切割	T2.1料件雷射切割機台模擬測試		P2.1.1 評估切割料件後，進行光路架設並確認電腦模擬操作。 P2.1.2 進行光路架設完成模擬並進行驗證。	3	K07雷射加工特性分析方法 K08光學料件概論 K09光路架設概論	S03文書撰寫能力 S04雷射切割模擬測試操作能力
	T2.2切割機台定位		P2.2.1 機台原點復歸及定位工作原點。 P2.2.2 判定機台或鏡頭的堪用程度。 P2.2.3 設定氣體壓力進給速度切削功率等切割條件。	3	K10切割機台調校概論	S05切割機台操作能力
	T2.3雷射切割打樣操作	O2.3.1打樣測試報告書	P2.3.1 依據客戶提供產品各種材質，進行材料切割條件的判定。 P2.3.2 根據實驗測試結果，分析實驗數據。 P2.3.3 根據擬定的實驗規劃，執行產品打樣及測試並產出測試報告書。	3	K07雷射加工特性分析方法 K08光學料件概論 K09光路架設概論 K11職業安全衛生相關規範 K12品質管制方法	S06料件打樣操作能力 S03文書撰寫能力
	T2.4雷射切割製程操作		P2.4.1 依據工作圖面進行工作分析與操作。 P2.4.2 依製程進行實務切割作業。	3	K06雷射加工特性分析方法 K07光學料件概論 K08光路架設概論 K11職業安全衛生相關規範 K12品質管制方法 K13精密量測概論	S07製作夾(治)具能力 S08雷射切割操作能力 S09個人防護裝備使用能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T3切割 機台保 養作業	T3.1切割 機台保養		P3.1.1 依雷射切割製程進行檢討與改善。 P3.1.2 按照雷射切割組件或模組，進行維護保養 作業。	3	K14機具維修與保養概要	S10切割機台維修與保養能力
	T3.2異常 狀況維修		P3.2.1 排除雷射切割生產製作產生的問題。	3	K14機具維修與保養概要	S11異常狀況初步研判與解決能 力

#### 職能內涵 ( A=attitude 態度 )

A01自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。

A02主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。

A03團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

A04壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。

A05正直誠實：展現高道德標準及值得信賴的行為，且能以維持組織誠信為行事原則，瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。

#### 說明與補充事項

● **建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件：**

- 高中(職)以上畢業。
- 具一年以上的相關工作經驗。

● **其他補充說明：**

- 金屬雷射切割相關技術工作：指利用雷射光束與物質相互作用的特性對材料進行切割、表面處理、打孔、微加工等工作。